

杰华特微电子股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司已制定 2024 年“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将进展情况公告如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司始终坚持虚拟 IDM 的经营模式，通过自主研发 BCD 工艺技术进行芯片设计与制造，具备芯片设计技术、系统设计技术及晶圆制造工艺技术等完整的核心技术架构。

公司产品以电源管理模拟芯片为主，在电源管理芯片领域拥有业界领先的全品类产品设计开发能力与产品覆盖广度，信号链芯片和其他产品组合持续丰富中。2024 年上半年，公司实现营业收入 75,051.79 元，同比增长 15.60%。公司将持续专注主营业务的深耕细作，致力于为各行业客户提供创新、高效、可靠的模拟半导体解决方案，持续为客户创造最大价值。

（一）打造独有工艺平台

公司旨在突破行业固有工艺水平限制，根据产品需求针对性研发特需工艺，使工艺制造水平与芯片开发需求相匹配，以实现芯片最优性价比。

目前，公司已在国内主要晶圆厂构建了 0.18 微米的 7 至 55V 中低压 BCD 工艺（部分电压段已延展至 90 纳米）、0.18 微米的 10 至 200V 高压 BCD 工艺、以及 0.35 微米的 10 至 700V 超高压 BCD 工艺等三大类工艺平台，各工艺条线均已迭代一至三代，初步形成了系统的自研工艺体系。

2024 年上半年，公司在现有工艺的基础上持续迭代，已经延展到 12 寸晶圆

90nm 及以下工艺，通过加强更低功耗、更高集成度、更高功率密度的工艺技术研 究，为更多差异化产品的研发奠定基础。

(二) 全品类产品布局

公司明确将业务发展战略定位为多产品线并行发展，通过不断丰富和拓展产 品种类，满足不同市场和客户群体的需求，从而增强公司的市场竞争力。截至目 前，公司已拥有 40 多条子产品线，在售型号达 2000 种，拥有广泛的产品组合， 涵盖 DC-DC、AC-DC、线性电源、电池管理、信号链、显示、汽车电子等，应 用范围涉及计算机、通讯、工业控制、服务器与数据中心、汽车电子、家用电器、 消费类电子、照明等众多领域，已成为综合性的模拟芯片供应商。凭借不断的工 艺迭代与研发创新，公司部分主要产品已处于国际先进水平，在多领域具备较强 竞争力。

2024 年上半年，公司通过精准的市场定位进行创新的产品设计，积极拓展 新能源、计算、汽车等新兴应用领域的市场份额。报告期内，公司发布了高集成 度 DC-DC 模块、升降压 (buck-boost) DC-DC、放大器，比较器，模拟开关等 多款产品，在新能源、汽车等领域得到了客户的肯定。在电子保护开关 (eFuse) 品类，公司推出多款业界领先水平功率管集成产品，包括 18V/25A、18V/50A 等， 具有导通功耗小、启动电流能力大、恶劣情况下保护性能强等优点，获得了计算 领域客户的广泛好评。在网通和安防领域，公司推出了多款 PoE 以太网供电芯 片，包括高集成 4 路 PSE 供电芯片，PD 受电端协议和功率全集成芯片，已通过 多家头部客户的测试。另外，公司推出了多款汽车应用的高低边驱动芯片，并基 本完成了汽车 LDO 的布局。

2024 年下半年，公司将继续发挥技术积累优势，聚焦计算领域大电流产品、 新能源领域模拟产品、汽车类产品等，从低功率到高功率全系列深入布局，进一 步满足客户需求。

(三) 加强客户拓展，提高市场占有率

公司针对经营目标深入市场调研，为产品的定义和开发提供依据；同时通过 参加多个线下展会及论坛活动，如第二十届武汉光博会、2024 亚洲快充大会、 2024 慕尼黑上海电子展等，并走进主机厂参加技术交流会，提高了公司品牌知

名度和产品的曝光率。公司凭借其多元化的产品线和优质的服务，成功地开拓了多家工控和新能源领域的头部客户。

公司将继续围绕自身产品战略布局，继续深耕市场和客户需求，坚持以“客户的痛点就是我们的发力点”为引领构筑战略合作伙伴关系，充分发挥双方优势，逐步拓宽合作领域，增强客户粘性，建立稳固的客户关系。另外，公司将持续探索新型客户合作模式，与战略客户共同成长，进而提升市场占有率。

(四) 推进公司降本增效建设

2024 年上半年，公司通过以下措施和方法降低运营成本，同时提高公司的经济效益和生产力，具体如下：

1、公司更多采用电路模块化设计，优化成熟 IP，持续改进研发流程和交付环节，进行自我迭代，大幅降低芯片改版次数，缩短产品研发交付周期，从而进一步提高研发的效率和成功率。同时，公司采用更先进的工艺技术（例如 90nm BCD 工艺平台），减小芯片尺寸，同时提高产品性能，大幅提升产品竞争力。

2、产品设计端通过可测性设计，简化产品测试过程中的测试复杂度，让产品测试更直接，更简洁，从而缩短测试时间，降低测试成本。产品生产端，成立专门团队，在保证测试稳定的前提下通过多 Site 模式缩短测试等待时间，优化程序代码提高程序的运行效率等手段降低主要量产产品的测试时间，最大化节约测试成本。

3、2024 年上半年，公司致力于提升预算管理的精细化水平，对业务流程中的重要成本费用实施了全面跟踪与监控。公司管理层从多个关键环节深入分析了人力成本、研发成本、生产成本的结构，采取了有效措施以减少非必要支出，确保资源合理分配。在此基础上，公司更加重视预算执行的严谨性，增强了审计监督力度，不仅提升了成本管理的透明度、成本结构的合理化，同时提升了全体员工预算控制的意识，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

(五) 关注模拟半导体行业并购机会

半导体行业逐步复苏，全球半导体收入较去年同期有所改善，市场需求呈现复苏态势，且迎来并购整合潮。公司始终围绕关键的应用场景，持续扩展产品系列。2024 年上半年，公司基于主营业务发展的战略考量，通过整合双方在产品、

技术、市场、客户以及供应链等方面的资源，先后将无锡市宜欣科技有限公司、无锡艾芯泽微电子有限公司、浙江芯塔电子科技有限公司纳入上市公司合并报表范围，通过优势互补进一步提升了公司的竞争力。

二、提升科技创新能力

（一）持续加大研发投入，加快研发成果转化

研发人员是集成电路公司在技术创新和产品开发中的核心力量，展现了公司的技术实力和创新水平。2024年上半年，公司研发人员总人数为635人，占员工总数的60.36%，同比增长37.74%。研发费用投入32,052.67万元，占营业收入的比重达到42.71%，较去年同期增加5.14个百分点。公司通过持续的研发投入，不断增加公司创新产出，推动公司的创新发展。2024年上半年，公司已申请国内外专利1,216项，其中发明专利871项；已获得有效国内外专利578项，其中发明专利355项。同时，公司获得工业和信息化部颁发的“国家制造业单项冠军企业”荣誉，体现了公司强大的创新能力以及公司产品的高质量和高效益。

为积极响应国家集成电路产业发展的战略需求，报告期内，公司与国内知名高校紧密携手，共同开展了实习实践联合培养项目。该项目旨在通过产学研合作模式，深化校企合作，共同培养一批高素质、实践能力强的集成电路领域专业人才。联合实践过程中，公司充分利用自身在集成电路产业的技术优势和实际工作经验，与高校共同设计了一系列贴近产业需求的实习实践课程。这些课程不仅涵盖了理论知识，更注重培养学生的实际操作能力和创新思维。公司还选派了一批经验丰富的工程师和技术人员，担任实习生的导师，对他们的学习和实践进行一对一指导。通过这一合作项目的实施，公司不仅为我国集成电路产业培养了一批急需的技能型人才，还加强了与高校之间的交流与合作，为我国集成电路产业的持续发展提供了有力的人才支撑。

未来，公司将继续专注于人才队伍建设，增强公司的人才培养能力，通过执业实践、学术培训、制度引导等方式进一步提升员工自身技术能力；同时，公司将大力吸引外部人才，增强团队综合实力，更好的应对快速变化的市场需求。公司也将通过股权激励、合理的奖惩制度、竞争机制等多层次措施调动员工的工作积极性、成就感，营造良好的人际互动和工作氛围提高员工的归属感。

（二）持续加强募投项目管理，保障募投项目顺利推进

公司于2022年12月在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币222,214.08万元。自上市以来，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关法规、制度，规范、安全、高效的管理募集资金，有序推进公司各募投项目的建设。2024年上半年，为更好发展和管理公司募集资金投资项目，公司增加全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司作为“模拟芯片研发及产业化项目”、“汽车电子芯片研发及产业化项目”、“先进半导体工艺平台开发项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。2024年5月31日经公司董事会、监事会审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，公司根据募投项目的实际情况，对部分募投项目内部投资结构进行调整，具体内容详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-024）。

截至报告期末，公司的募投项目进展情况如下：

1、高性能电源管理芯片研发及产业化项目

本项目是进行公司新大楼的建设以及高性能移动设备电源产品的研发及产业化，经公司股东大会审议通过，公司使用超募资金10,000.00万元用于增加本募投项目的投资规模，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。截至2024年上半年，本项目总投资金额为49,104.84万元，计划投入募集资金总额为41,104.84万元。报告期末，本项目已累计投入22,193.07万元，投入进度达53.99%，预计2024年12月达到可使用状态。

2、模拟芯片研发及产业化项目

本项目总投资金额为43,970.59万元，计划投入募集资金金额为43,970.59万元，报告期末，已累计投入13,751.52万元，投入进度达31.27%，预计2026

年 12 月将产生效益。本项目实施有利于进一步提高公司产品性能、提高公司研发水平，公司将继续按计划推动本募投项目的建设，监控项目的进度和质量。

3、汽车电子芯片研发及产业化项目

报告期末，累计投入募集资金 9,289.50 万元，投入进度达 30.01%。本项目将助力于公司在汽车电子领域拓展市场空间，实现车规级产品核心技术和产业化的突破，巩固和提高公司在汽车电子芯片行业中的地位和竞争力。

4、先进半导体工艺平台开发项目

本项目是对公司 12 寸中低压 BCD 工艺、高压及超高压 BCD 工艺等多个半导体工艺平台进行持续开发，提升公司核心竞争优势。报告期末，已累计投入 6,319.62 万元，投入进度达 30.00%，公司将按照计划进度积极、有序推进项目的建设。本项目旨在突破行业固有工艺水平限制，满足客户需求，赢得市场竞争优势。

2024 年下半年，公司将进一步加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，提升公司产品技术实力，更好的拓展公司的市场规模。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视治理结构的健全和内控体系的有效性，2024 年上半年公司积极开展第二届董监高的换届事宜，于 2024 年 5 月 31 日顺利完成了所有董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的换届工作，公司将持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，筑牢高质量发展根基，全面保障股东权益。具体方案如下：

（一）深化独立董事制度

公司依据《上市公司独立董事管理办法》组建了由公司独立董事组成的独立董事专门会议，2024 年上半年公司共召开了 2 次独立董事专门会议。组建的独董专门会议为独立董事履行职责提供了必要的便利条件，确保独立董事享有充分的知情权和行使特别职权，以充分发挥独立董事在公司治理体系中的核心作用。

2024 年公司将进一步深化对独立董事制度的执行力度，致力于提升独立董事的履职效能，继续为独立董事专门会议提供了全方位的便利条件，包括但不限于提供必要的工作资源、信息支持和服务保障，确保独立董事在履行职责时能够

无障碍地获取相关信息，充分保障其知情权。同时，公司也明确赋予了独立董事特别的职权，使其能够在关键时刻发挥关键作用，比如在审议重大关联交易、监督公司合规运作等方面，为公司的长远发展和稳健运营奠定坚实的基础。

（二）完善内控建设

公司根据相关法律法规和内部管理需求，已制定了完整的一套内控制度文件，规范了财务、运营、合规等各个方面，明确了各个岗位的职权，规范了工作流程。公司根据实际经营发展情况于2024年5月31日经股东大会审议通过，对公司《对外投资决策管理制度》进行了修订。2024年8月公司根据相关规范性文件的规定以及为进一步提升公司法人治理结构的科学性和合理性，对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度进行了修订，并制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，促进了公司规范治理。

同时，公司常态化运行内控审计和财务审查，加强募集资金管理、关联交易、对外担保、资产收购、工程项目等重大事项的控制审核；狠抓标准化管理体系建设，包括合同管理、印章管理、研发管理、资产管理等流程，做好风险预防与识别控制；完善与内控相关的流程和信息系统化建设，提升了数据分析和风险预警能力；加强内部组织控制，不定期排查子公司业务流程和财务报表，及时发现和纠正不规范操作，以确保各项业务活动符合公司整体战略目标和内控要求，提升了公司的运营效率和管理水平。

后续，公司将进一步加强内控风险的评估，根据外部、内部环境的变化，及时调整风险措施，完善公司内控建设，确保公司经济活动的合法合规性。

（三）管理层约束

公司董事、高级管理人员均忠实于公司，勤勉地履行职责，遵守法律法规，保持着公司利益与个人利益之间的清晰界限，不利用职务之便进行不正当的利益输送，不损害公司及股东的利益，确保公司的健康稳定发展。

（四）董监高相关培训

自上市以来，公司及时向董监高传递最新的证券法律法规和证监会的监管政策，确保董监高准确把握监管要求，提高规范运作意识。另外，公司积极组织董监高参与证监局、交易所等监管机构举办的相关培训，加强证券市场法律法规的

学习，及时了解相关法律法规，不断提升风险及自律意识，护航公司高质量发展。

四、加强与投资者沟通，建立长期互信通道

公司自上市以来始终高度重视投资者保护和投资者关系管理，通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，实现尊重投资者、保护投资者之目的。

2024年上半年，公司利用E互动、投资者热线、电子邮件等多元化渠道，合法合规的就投资者关心的各类问题给予了积极的回复，其中公司通过上证e互动积极回答投资者关心的问题，回复率为100%。同时，公司保持着业绩说明会常态化，公司2023年年报以及2024年第一季度报告发布后于2024年5月17日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，对公司财务状况、经营情况等进行了说明，并就投资者关心的问题进行交流，维护了公司与投资者之间良好关系。除此之外，公司积极发布新品、开展主题演讲等形式展新品、亮技术和深交流，直观展现公司竞争力，提振市场信心，并通过图文或视频的形式发布至公司微信公众号、官网等信息传递渠道，让投资者能及时了解公司发展动态。

公司积极践行ESG理念，于2024年4月30日首次披露了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》，向社会公众全方位展示了公司在绿色可持续性发展、员工福利以及社会责任方面的杰出成就。

2024年下半年，公司将会更好地执行证券监管的规定，更紧密地关注资本市场的发展，积极地提高投关频率，提高交流质量，向资本市场高效地传递企业价值，同时将投资者关心的问题、提出的建议等及时向公司管理层反馈，以便能够对市场变化做出积极的反应。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

(一) 强化股权激励及约束

股权激励计划有利于公司进一步建立健全公司的长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。公司鉴于2023年度实施的激励计划首次授予部

分第一个归属期公司层面业绩考核未达标,于2024年4月28日经公司董事会审议通过,公司作废相关限制性股票数量。

公司于2024年8月推出了2024年股权激励计划,拟向激励对象授予1,847.8285万股限制性股票。公司以营业收入为公司层面的业绩考核目标,与员工个人层面绩效考核相结合,并设置了分批次归属安排,增强员工的归属感及长期忠诚度,有效调动员工的工作积极性,实现公司与员工共同成长的目标。

(二) 制定与公司经营业绩挂钩的结构化薪酬体系

公司以实际的业绩效果为考核评价依据建立动态的薪酬调整机制。公司高管在薪酬方面,依据其工作职务、年度工作考核结果并结合公司年度经营业绩等因素综合确定报酬,充分体现了高管收入与工作业绩挂钩,其薪酬结构由基本工资、业绩奖金以及股权激励等部分构成。公司根据年初制定的绩效目标、重点工作等业绩指标,组织开展了中期绩效考核工作,并结合公司半年度业务成果和盈利情况给予综合评级,确保薪酬体系能够公平、公正、有效地实施。

公司未来将继续不断改进绩效考核体系,有效融合员工个人利益与公司整体效益,进一步巩固高管与股东之间的利益共享与共担机制,推动公司实现持续、稳健、长远的发展。

六、其他事宜

2024年下半年,公司将继续实施“提质增效重回报”行动方案的各项举措,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业,提升经营质量,并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2024年8月29日